

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/2023/OPTOKRYPT

Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

1. Płyta bazowa dedykowana do modułu komputerowego w standardzie COM-HPC Server	3
1.1. Specyfikacja.....	3
1.2. Inne informacje	3
2. Moduł komputerowy typu COM-HPC	4
2.1. Specyfikacja.....	4
2.2. Inne informacje	4

1. Płyta bazowa dedykowana do modułu komputerowego w standardzie COM-HPC Server

1.1. Specyfikacja

- Interfejsy wewnętrzne:
 - co najmniej 2 interfejsy PCIe x16,
 - co najmniej 2 interfejsy PCIe x8,
 - co najmniej 3 interfejsy PCIe x4,
 - co najmniej 2 podwójne interfejsy USB 2.0,
 - złącze typu M.2 Key M 2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110,
 - co najmniej 8 interfejsów Ethernet KR,
 - co najmniej 2 interfejsy SATA,
 - zasilanie SATA,
 - co najmniej 2 interfejsy UART DB, w tym:
 - co najmniej 1 interfejs UART DB9 BMC,
 - co najmniej 1 interfejs UART DB9 konsoli BMC,
 - co najmniej 1 interfejs GP SPI,
 - co najmniej 1 interfejs I2C,
 - co najmniej 1 interfejs SMB,
 - co najmniej 1 interfejs eSPI,
 - co najmniej 1 interfejs SPI,
 - co najmniej 1 interfejs GPIO,
 - co najmniej 3 interfejsy zasilania wentylatorów;
- Interfejsy zewnętrzne:
 - co najmniej 4 interfejsy USB3.2 Gen 1 Type A,
 - co najmniej 1 interfejs 10GbE RJ45,
 - co najmniej 1 interfejs GbE RJ45;
- Zasilanie:
 - złącze ATX lub złącze bananowe (12VDC);
- Temperatura pracy:
 - od nie więcej niż -25°C do nie mniej niż +40°C;
- Temperatura składowania:
 - od nie więcej niż -40°C do nie mniej niż +70°C;
- Wilgotność pracy:
 - od nie więcej niż 10% do nie mniej niż 90%;
- Wilgotność składowania:
 - od nie więcej niż 5% do nie mniej niż 95%.

1.2. Inne informacje

Liczba sztuk: 1 sztuka.

2. Moduł komputerowy typu COM-HPC

2.1. Specyfikacja

- Procesor Xeon D-2796TE lub równoważny (wyposażony w nie mniej niż 20 rdzeni 2.0 GHz, nie mniej niż 30 MB cache oraz spełniający wymienione poniżej wymagania temperaturowe);
- Zintegrowany chipset;
- RAM:
 - co najmniej 4 gniazda DIMM dla modułów pamięci DDR4,
 - maksymalna pojemność nie mniejsza niż 512 GB;
- Ethernet:
 - co najmniej 1 interfejs 2.5GbE TSN Ethernet,
 - możliwość przystosowania do następujących konfiguracji: 2x 40G / 4x 25G / 8x 10G/2.5G/1G/100M;
- I/O:
 - co najmniej 32 interfejsy PCIe Gen4,
 - co najmniej 16 interfejsów PCIe Gen3,
 - co najmniej 4 interfejsy USB 3.0,
 - co najmniej 4 interfejsy USB 2.0,
 - co najmniej 2 interfejsy SATA III (6Gb/s),
 - co najmniej 2 interfejsy UART,
 - co najmniej 12 interfejsów GPIO,
 - co najmniej 2 interfejsy SMBus,
 - co najmniej 2 interfejsy I2C;
- BIOS:
 - Oprogramowanie układowe zgodne z UEFI,
 - możliwość wgrania własnego logo,
 - możliwość konfiguracji ustawień domyślnych,
- Moduł Trusted Platform Module (TPM 2.0);
- Możliwość instalacji co najmniej następujących systemów operacyjnych:
 - Microsoft Windows 10,
 - Microsoft Windows 10 IoT Enterprise,
 - Microsoft Windows IoT 10 Core,
 - Linux;
- Temperatura pracy:
 - od nie więcej niż -25°C do nie mniej niż +40°C;
- Temperatura składowania:
 - od nie więcej niż -40°C do nie mniej niż +70°C;
- Wilgotność pracy:
 - od nie więcej niż 10% do nie mniej niż 90%;
- Wilgotność składowania:
 - od nie więcej niż 5% do nie mniej niż 95%.

2.2. Inne informacje

Liczba sztuk: 1 sztuka.